

WTA 60 晶圆临时键合胶 产品数据表

优异的保护性能
易于去除
低缺陷率

简介

WTA 60 是一种牺牲型晶圆临时键合胶, 专为薄晶圆加工保护而设计, 可在不损伤薄晶圆的前提下, 使标准半导体设备按常规工艺运行。WTA 60 可通过旋涂或点胶方式施涂于晶圆表面。涂覆完成后, 可在室温条件下干燥, 或在升高温度下进行预烘(Pre-bake); 随后在加压条件下, 将玻璃载板进行热压键合至晶圆表面。在半导体制程完成后, 可使用 YINCAE WTR 50, 在 50 °C 条件下, 通过玻璃载板上的通孔溶解 WTA 60, 从而完成解键合过程。

物理特性

产品名称	WTA 60 临时键合胶
外观	透明无色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D 1475-60)	0.99 – 1.05 g/cc
粘度(ASTM D-1384)	3000 – 8000 cP
保质期	6 个月

已固化材料性能	
球压硬度 (30 s) (ISO 2039)	130
耐湿性 (85 °C / 95% RH, 120 天) (IPC-CC-830)	通过
体积电阻率 ($\Omega \cdot m$)	$> 10^{14}$
Tg (ASTM D3418-82)	65 °C
C.T. E (ASTM E 831) PPM / °C	$\alpha_1 = 65$
失重率 (300 °C) (TGA)	0 %
附着力 (ASTM D2197)	中等
吸湿率 (ASTM D-570)	< 0.01 %
提取离子 (MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	< 5 ppm

推荐干燥工艺

WTA 60 可在室温条件下干燥，或在升高温度条件下进行干燥/预固化，以满足后续热压键合工艺需求。

储存与保质期

在室温条件下，若材料存放于密封的原始包装容器中，保质期为 12 个月。超过该期限存放，产品粘度可能会升高。储存时应避免 紫外光照射、水分侵入、挥发及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全须知

WTA 60 为一种环保、无毒材料。但在使用和操作过程中，仍建议遵循一般工业卫生规范。有关更详细的安全信息，请参阅本产品的 SDS (安全数据表)。



YINCAE Advanced Materials, LLC
93 Broadway
Menands, NY, 12204
T (518) 452-2880
F (518) 452-2779

包装规格

WTA 60 晶圆临时键合胶提供 **1 加仑 (1 gallon)** 标准包装规格。根据客户需求, 亦可提供其他包装形式。如需订购或获取更多信息, 请联系 YINCAE。